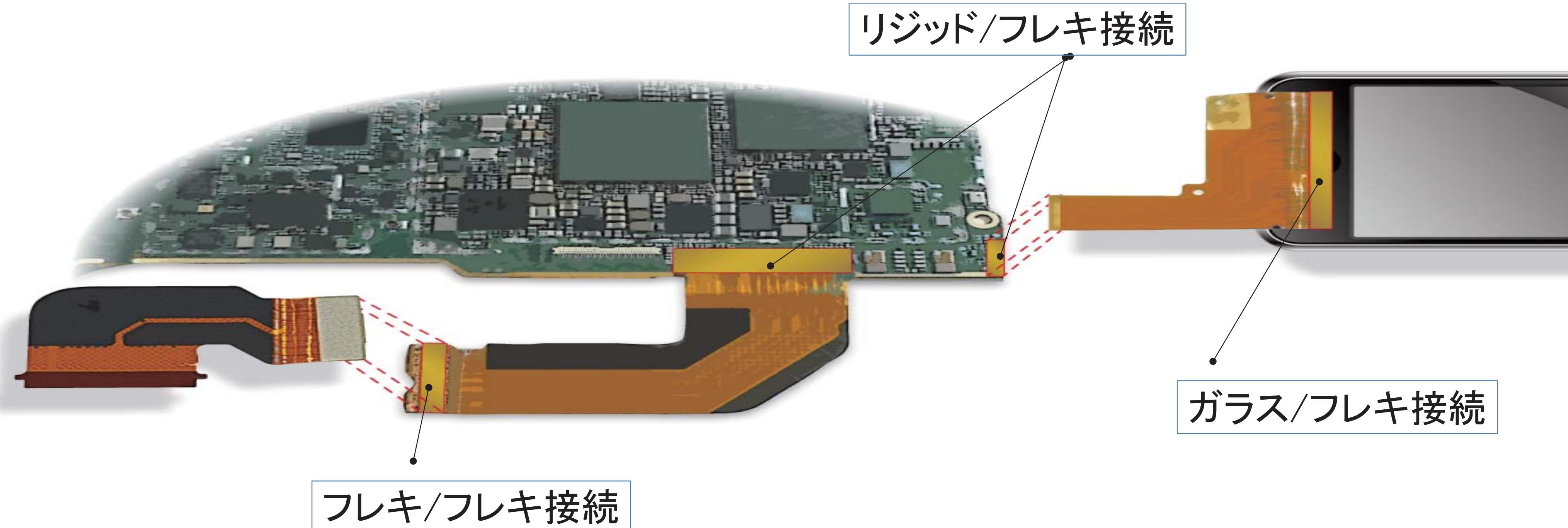


異方導電性接着剤

Anisotropic Conductive Adhesives
ELEPASTE JB100

コネクタ/ACFの代替が可能な異方導電性接着剤

使用例

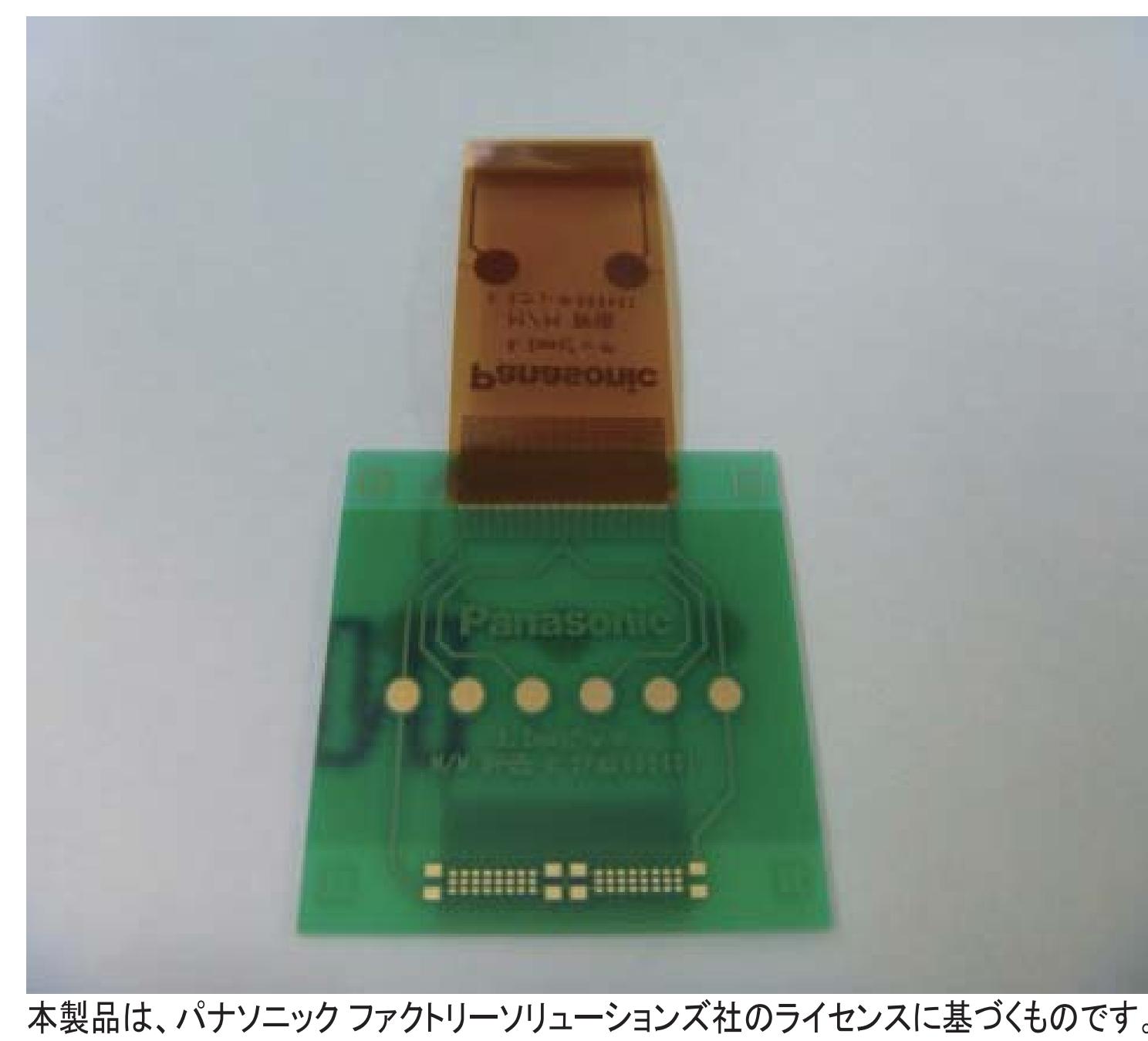


特徴 Features

- 低温短時間での硬化が可能(150°C 5秒硬化)
Quick cure at low temperature (150deg.C 5sec.)
- 低圧力での接続が可能(1MPa)
Low pressure connection (1MPa)
- 低背接続(0.1mm)
Connectable to lower profile patterns (0.1mm)
- 気泡の少ない接続が可能
Minimize void at connection process
- FPC基板、ガラス基板への接着性良好
Excellent adhesive strength to glass substrate and an FPC board
- リワークが可能
Easy reworkability

信頼性試験(リジッド/フレキ接続)

	条件	評価結果
接着強度 Adhesion strength	90° peel	20N/cm
熱衝撃 Thermal shock	-40°C/125°C	1000cycle
耐湿性 Humidity resistance	85°C/85%RH	500h
絶縁性 Insulation	85°C/85%RH 15V	500h



本製品は、パナソニックファクトリーリユーションズ社のライセンスに基づくものです。
This product is licensed by PFSC



太陽インキ製造株式会社